

Panne à souder en biseau 30° 0,8 mm sans plomb, série S - Thermaltronics S75CH008

Réf. article WL38240

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder en biseau sans plomb d'une largeur de 0,8 mm et un angle de 30° pour la série S Thermaltronics. Température de travail de 350 à 398 °C, conforme RoHS. Compatible avec le fer SHP-SM et les unités de commande Metcal MFR.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Panne à souder sans plomb de la série S Thermaltronics, forme en biseau avec une largeur de 0,8 mm et un angle de 30°. La plage de température de 350 à 398 °C convient aux soudures sans plomb sur cartes et composants à demande thermique moyenne à élevée.

AVANTAGES

- Largeur de panne 0,8 mm, angle 30° pour un transfert de chaleur ciblé
- Température de travail de 350 à 398 °C, conforme RoHS et sans plomb
- Chauffage directement dans la panne pour une récupération thermique rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38240
Réf. fabricant	S75CH008
Fabricant	Thermaltronics
Série	S (SSC)
Forme de panne	burin micro fine
Angle	30°
Largeur de panne	0,8 mm

Longueur de panne	13 mm
Plage de température	350 - 398 °C
Type	Panne à souder, sans plomb

APPLICATIONS

- Soudage manuel et reprise sans plomb en fabrication électronique
- Soudage de composants CMS et traversants

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Fer compatible : SHP-SM (station Thermaltronics TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161, SP200)
- Unités de commande compatibles : TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (pannes SSC)
- Contenu de la livraison : 1 panne à souder

Conforme RoHS, sans plomb. Origine : États-Unis.